

証券コード：6599

EBRAIN エブレン株式会社

The background of the slide is a futuristic cityscape with a blue and white color scheme. The buildings are stylized and appear to be constructed from circuitry or data lines. A bright light source is visible in the upper right quadrant, creating a lens flare effect. The word "EBRAIN" is prominently displayed in the center of the image in a bold, red, italicized font.

EBRAIN

2022年3月期末 会社説明資料

- 会社概要
- 事業内容の説明
- 2022年3月期(第49期)決算状況
- 2023年3月期(第50期)見通し
- 成長への取り組み

| | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| 設 | 立 | 1973年（昭和48年）10月 | | |
| 本 | 社 | 東京都八王子市石川町 | | |
| 資 | 本 | 金 | 1億4,301万円 | |
| 売 | 上 | 高 | 39億2,200万円（2022年3月期） | |
| 経 | 常 | 利 | 益 | 5億2,900万円（同上） |
| 従 | 業 | 員 | 数 | 118名（2022年3月現在） |
| 事 | 業 | 所 | 東京都八王子市、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区 | |
| 子 | 会 | 社 | 蘇州エブレン（蘇州惠普聯電子有限公司：中国江蘇省蘇州市） | |
| 事 | 業 | 内 | 容 | 産業用電子機器・工業用コンピュータの設計製造販売 |

- 現在のメインの仕事内容は、
通信・電力・鉄道・医療などの「**社会インフラ系設備**」および
半導体製造装置や生産自動化機械などの「**産業インフラ系設備**」に、
コントローラとして使用される**産業用コンピュータ**の
受託設計と受託生産が中心で、売上の80%以上を占めています。

通信・放送



- 鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、
大手の装置メーカーが主契約者となっていて、私どものビジネスのポジシ
ョンとしては、その下になります。

鉄道



- 主契約者の装置メーカーは、設備やシステムの開発構想に基づいて、
当社へ委託するコンピュータ製品の「**要求仕様書**」を作成して提示し、
私共はその「**要求仕様**」に基づいて**製品を設計**し、試作品を作って装置
メーカーへ送り、評価と設計検証を受けます。

医療

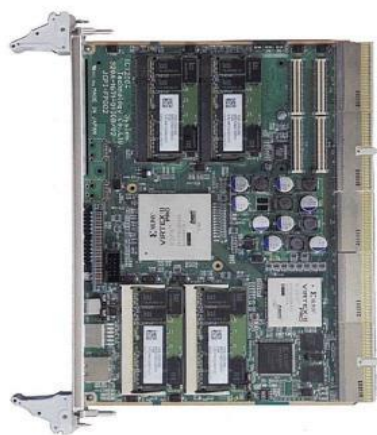


- 量産に入る迄に半年とか一年以上の期間を要する事もありますが、
量産開始以降は中長期的に安定した製品供給を要求されます。

半導体製造装置



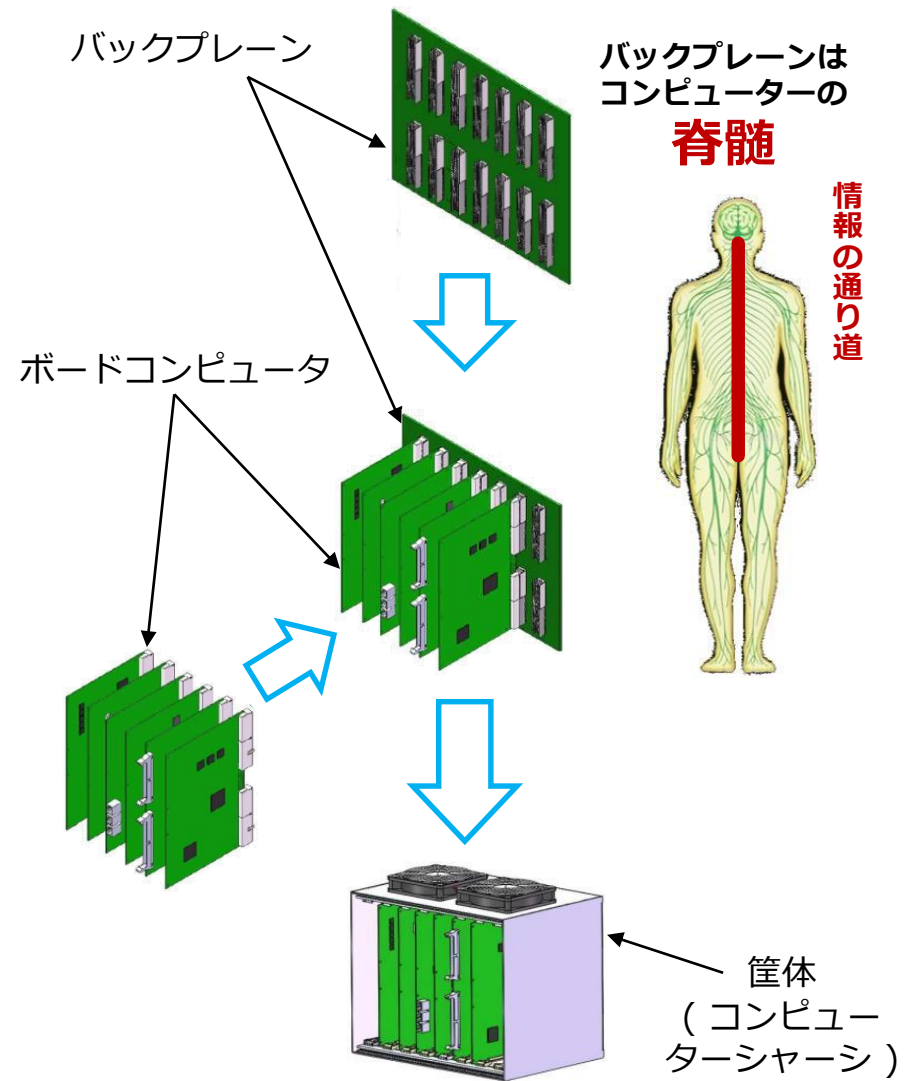
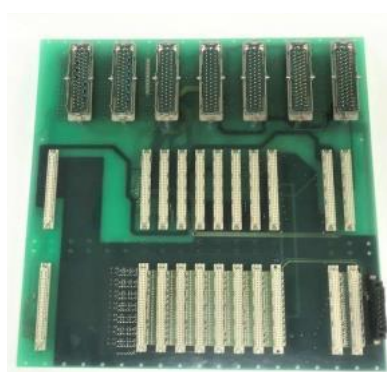
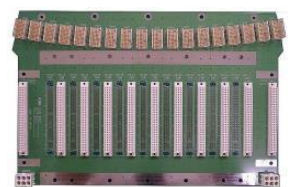
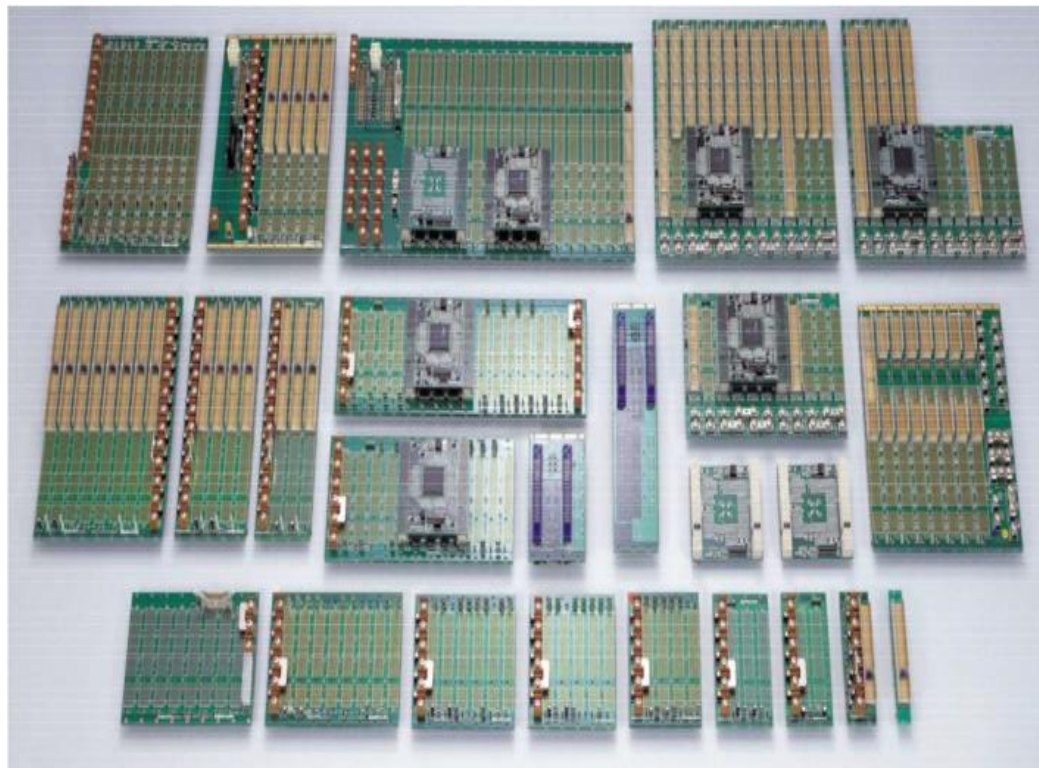
- バックプレーンシステム用
ボードコンピュータ



- IoT・Edge システム用
ワンボードコンピュータ



製品区分(2) バックプレーン

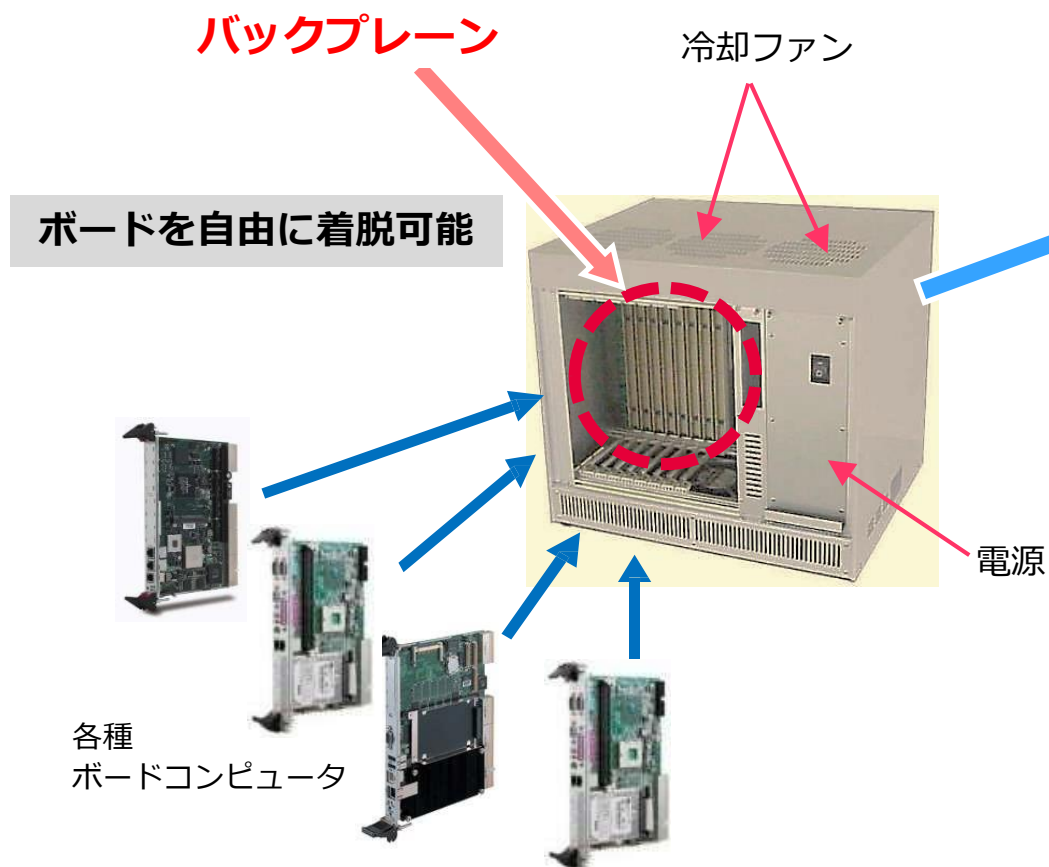


- バスラック
(バックプレーン搭載型シャーシ)



- ワンボード型シャーシ
(IoT・Edgeシステム用)





(例・半導体製造装置)

バックプレーン

【役割】
各種回路基板を相互に接続して
信号伝送や電力供給を行う

冷却ファン

筐体

ガイドレール

電源



ボードコンピュータ

【バックプレーン方式の利点】

ボードコンピュータが自在に着脱可能

1. 保守性

ホットスワップ、
保守体制、保守要員、

2. 拡張性

拡張スロット、増設、
機能追加、

3. 汎用性

市場に流通しているボードコンピュータ
を採用する事が可能。

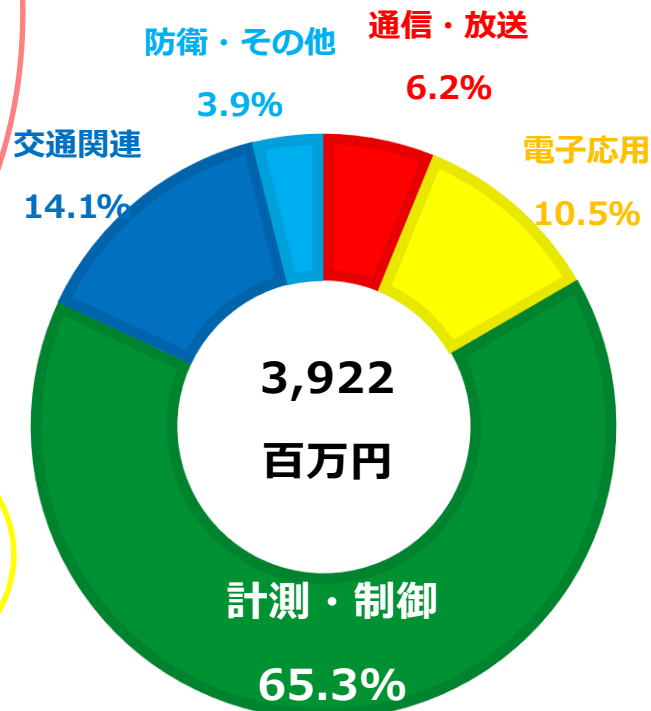
多くの産業用コンピュータで
バックプレーン方式が採用される

エブレン製品の用途（応用分野）

産業インフラ・社会インフラ関連の大手企業と安定的な取引関係を継続



連結売上高構成比
2022年3月期



主要納入先 (直接納入,間接納入を含む)

各分野の主要メーカーへ納入

NEC

NEC グループ各社

HITACHI
Inspire the Next

日立製作所
グループ各社

FUJITSU

富士通グループ各社

住友電工
Connect with Innovation

住友電気工業 (株)

GE Healthcare

GE Healthcare
グループ各社

Preferred Networks

(株) プリファード・
ネットワークス

三菱重工

三菱重工
グループ各社

MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機
グループ各社

Kawasaki

川崎重工業
グループ各社

TEL

東京エレクトロン
グループ各社

Canon

キヤノンメディカル
システムズ (株)

古河電工

古河電気工業 (株)

KYOSAN

(株) 京三製作所

viswill

第一実業ビスウィル (株)

Panasonic

パナソニック
グループ各社

TOSHIBA

東芝 グループ各社

Lasertec

レーザーテック (株)

OLYMPUS

オリンパスメディカル
システムズ (株)

Nikon

(株) ニコン

SCREEN

(株) SCREENセミコンダクター
ソリューションズ

日本信号株式会社

日本信号 (株)

SONY

ソニーグローバル
マニュファクチャリング&
オペレーションズ

MEIDEN

(株) 明電舎

TOKYO KEIKI

東京計器 (株)

Anritsu

アンリツ (株)

SAMSUNG

サムスン電子
グループ各社

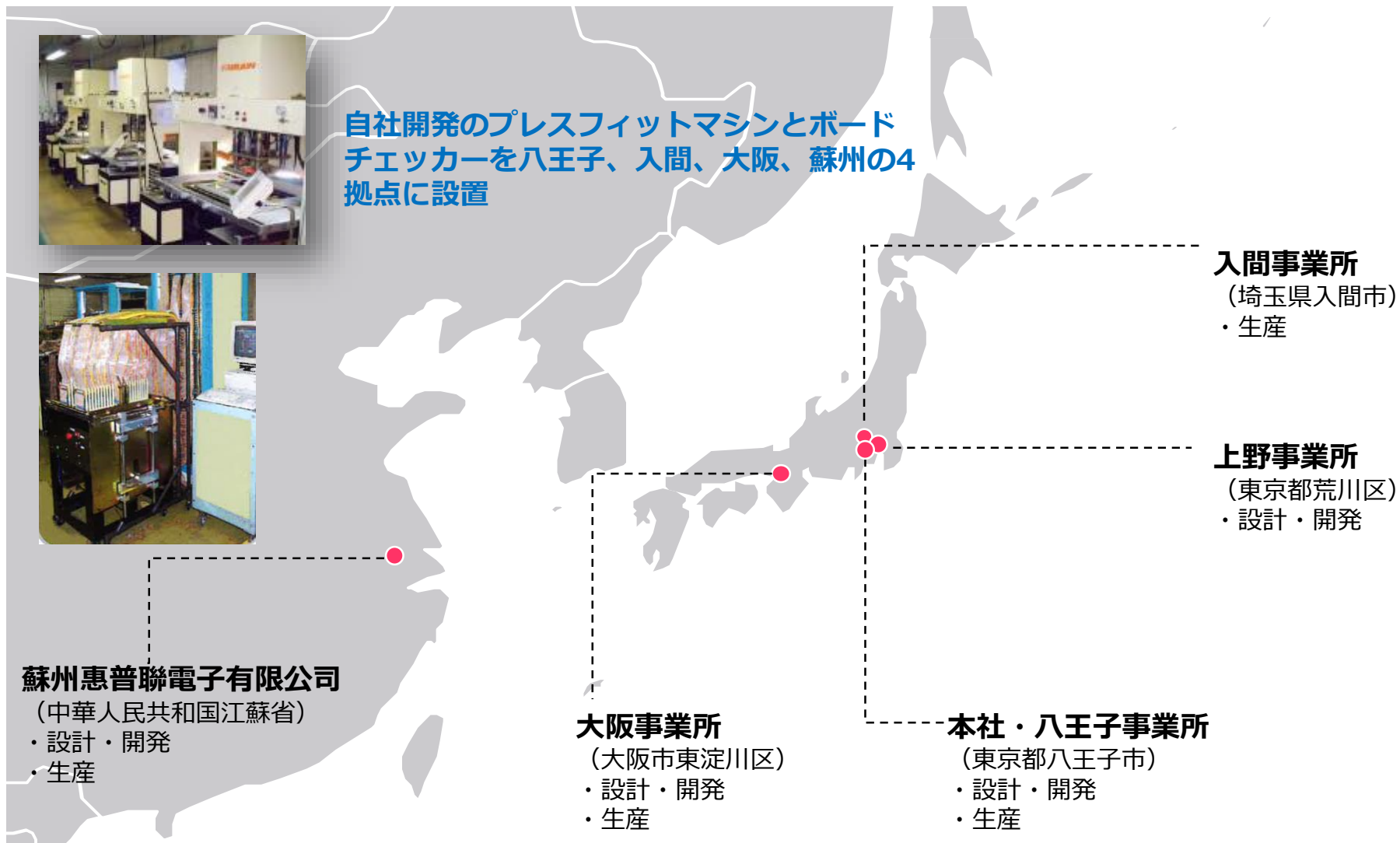
USHIO

ウシオ電機 (株)

ONOSOKKI

(株) 小野測器

BCPの観点から共通の設備で複数の生産拠点で生産



証券コード：6599

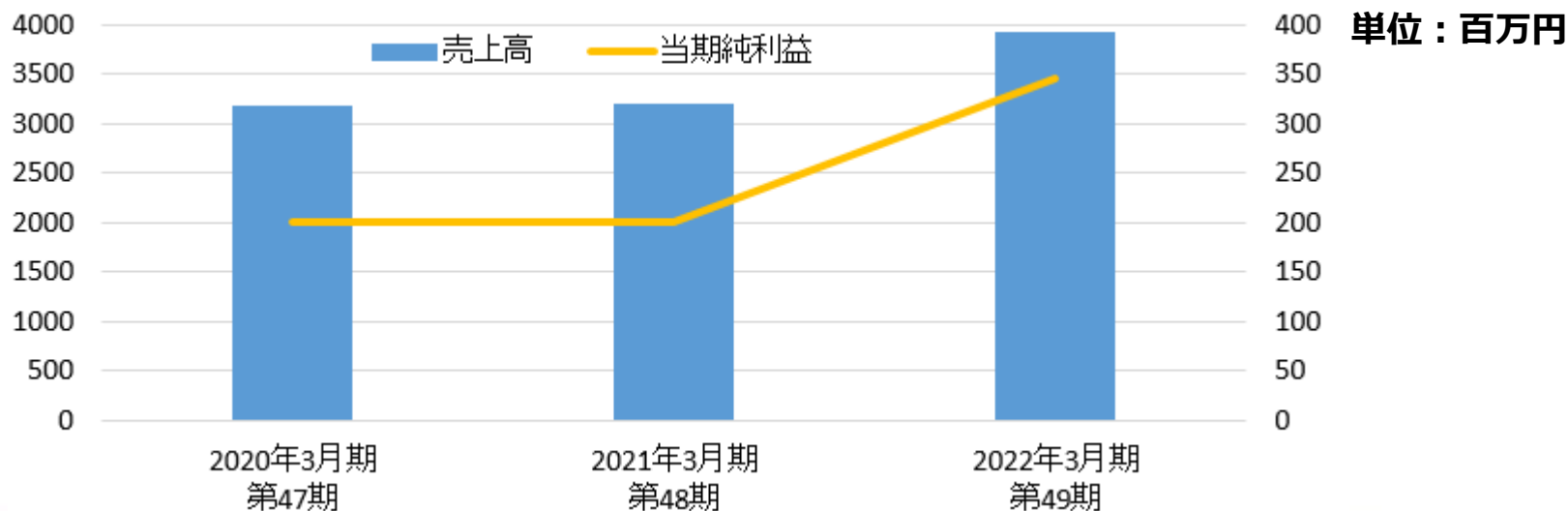
EBRAIN エブレン株式会社



2022年通期 業績報告

2022年3月期 (第49期) 決算実績

| 連結損益計算書 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 増減率 |
|---------|--------|--------|--------------|--------|
| 売上高 | 3,183 | 3,202 | 3,922 | 122.5% |
| 営業利益 | 284 | 298 | 537 | 180.1% |
| 営業利益率 | 8.9% | 9.3% | 13.6% | |
| 経常利益 | 304 | 300 | 529 | 176.2% |
| 経常利益率 | 9.5% | 9.3% | 13.4% | |
| 当期純利益 | 200 | 200 | 345 | 172.5% |
| 当期純利益率 | 6.3% | 6.2% | 8.7% | |



計測・制御 (半導体製造装置)

- ✓ 先行的な調達で部材調達難による出荷停止を回避
- ✓ 半導体供給不足を背景に半導体製造装置への設備投資が加速
- ✓ 半導体の需要が引き続き堅調
- ✓ その影響も受け、当期の売上は前年比**41.1%増**となった
1,815百万円→2,560百万円 (745百万円↑)

交通関連

- ✓ 緊急事態宣言による移動制限の影響で鉄道会社の設備投資延期
- ✓ 海外向け鉄道関連の入札延期、設置工事遅延
- ✓ 売上は前年比**1.8%減**
564百万円→554百万円 (10百万円↓)



通信・放送

- ✓ 電力・放送関連は予定通りに推移
- ✓ 通信インフラ増強計画はあったが半導体入手難による影響を受けた
- ✓ 売上は前年比**38.6%減**

392百万円→241百万円 (151百万円↓)



電子応用

- ✓ 先送りされていた高額医療装置への設備投資が再開
- ✓ 売上は前年比**42.1%増**

291百万円→412百万円 (121百万円↑)



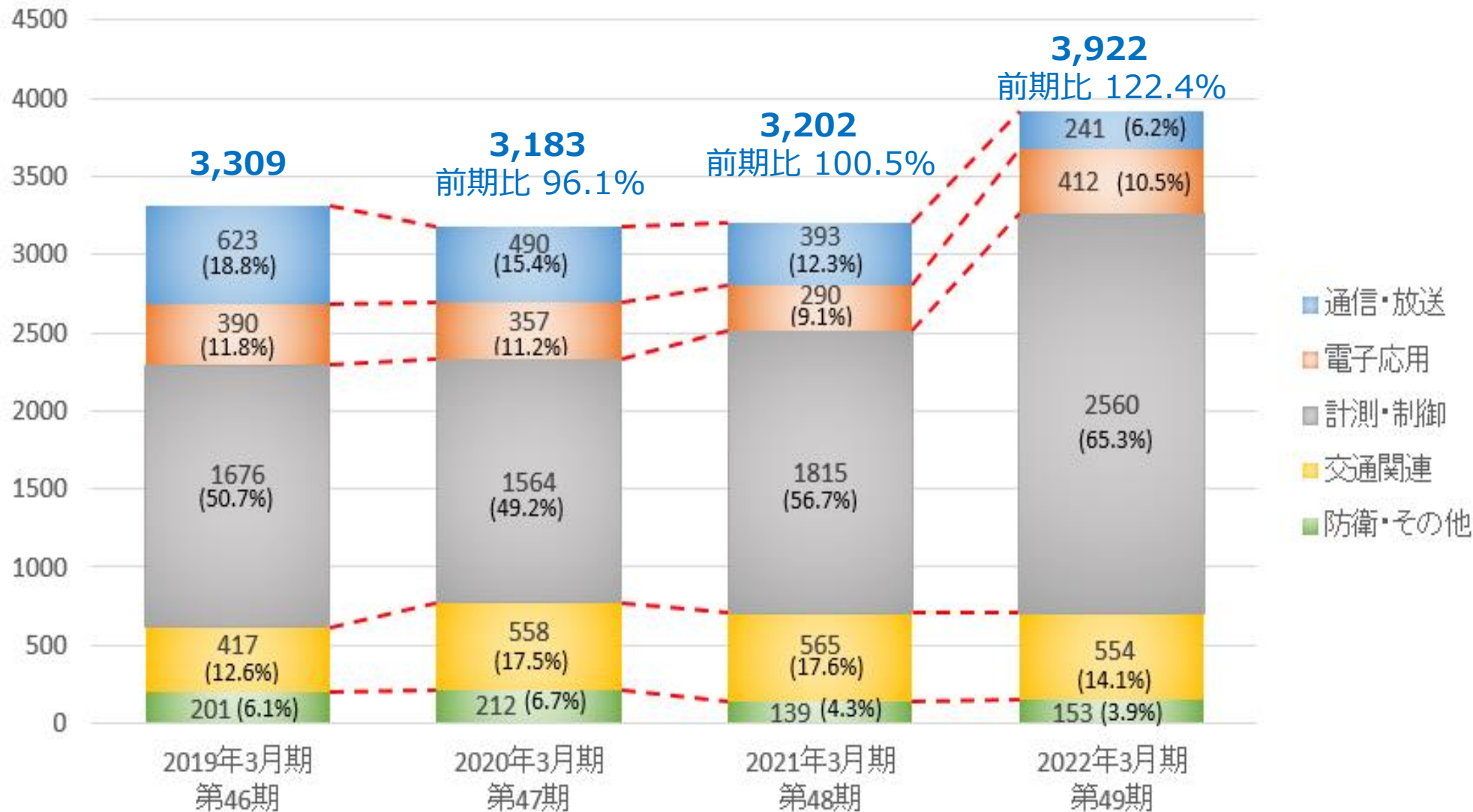
防衛・その他

- ✓ 売上は前年比**10.4%増**

139百万円→153百万円 (14百万円↑)

連結応用分野別売上推移

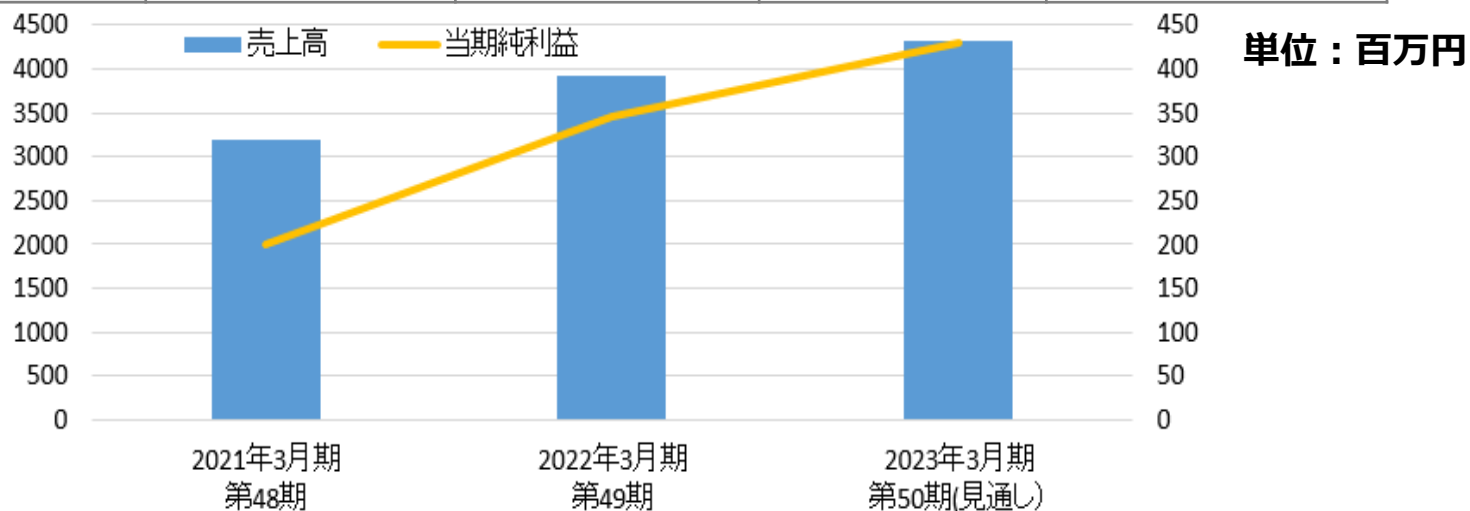
単位:百万円



| | 2021.3 (百万円) | 2022.3 (百万円) | 前期末比 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|
| 流動資産 | 3,306 | 3,907 | 118.1% |
| 固定資産 | 1,275 | 1,277 | 100.1% |
| 資産合計 | 4,582 | 5,184 | 113.1% |
| 流動負債 | 769 | 1,018 | 132.3% |
| 固定負債 | 364 | 374 | 103.0% |
| 負債合計 | 1,134 | 1,392 | 122.7% |
| 純資産 | 3,448 | 3,791 | 109.9% |
| 負債純資産合計 | 4,582 | 5,184 | 113.1% |
| 自己資本比率 | 75.2% | 73.1% | |

2023年3月期 (第50期) 通期予想

| 連結損益計算書 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 (見通し) | 増減率 |
|---------|--------|--------|-----------------|--------|
| 売上高 | 3,202 | 3,922 | 4,320 | 110.1% |
| 営業利益 | 298 | 537 | 650 | 120.9% |
| 営業利益率 | 9.3% | 13.6% | 15.0% | |
| 経常利益 | 300 | 529 | 650 | 122.7% |
| 経常利益率 | 9.3% | 13.4% | 15.0% | |
| 当期純利益 | 200 | 345 | 430 | 124.5% |
| 当期純利益率 | 6.2% | 8.7% | 9.9% | |



分野によって好不調が大きく分かれる



計測・制御 (半導体製造装置)

- ✓ スマホ・自動車・データセンター向けを中心に半導体需要が拡大
- ✓ 半導体製造装置市場の増加は継続する
- ✓ ウクライナ問題、新型コロナウイルスの影響で半導体製造装置生産に支障を来す可能性もあり
- ✓ 部品入手難顕在化リスク



交通関連

- ✓ 交通・車両関係は例年並みを予測
- ✓ 海外向け案件を中心に新型コロナウイルスの影響により設備投資延期の可能性

分野によって好不調が大きく分かれる



通信・放送

- ✓ 新規電力案件の量産開始
- ✓ 放送分野で前期分からの後ろ倒し



電子応用

- ✓ 医療関係を中心に前年並みを予測

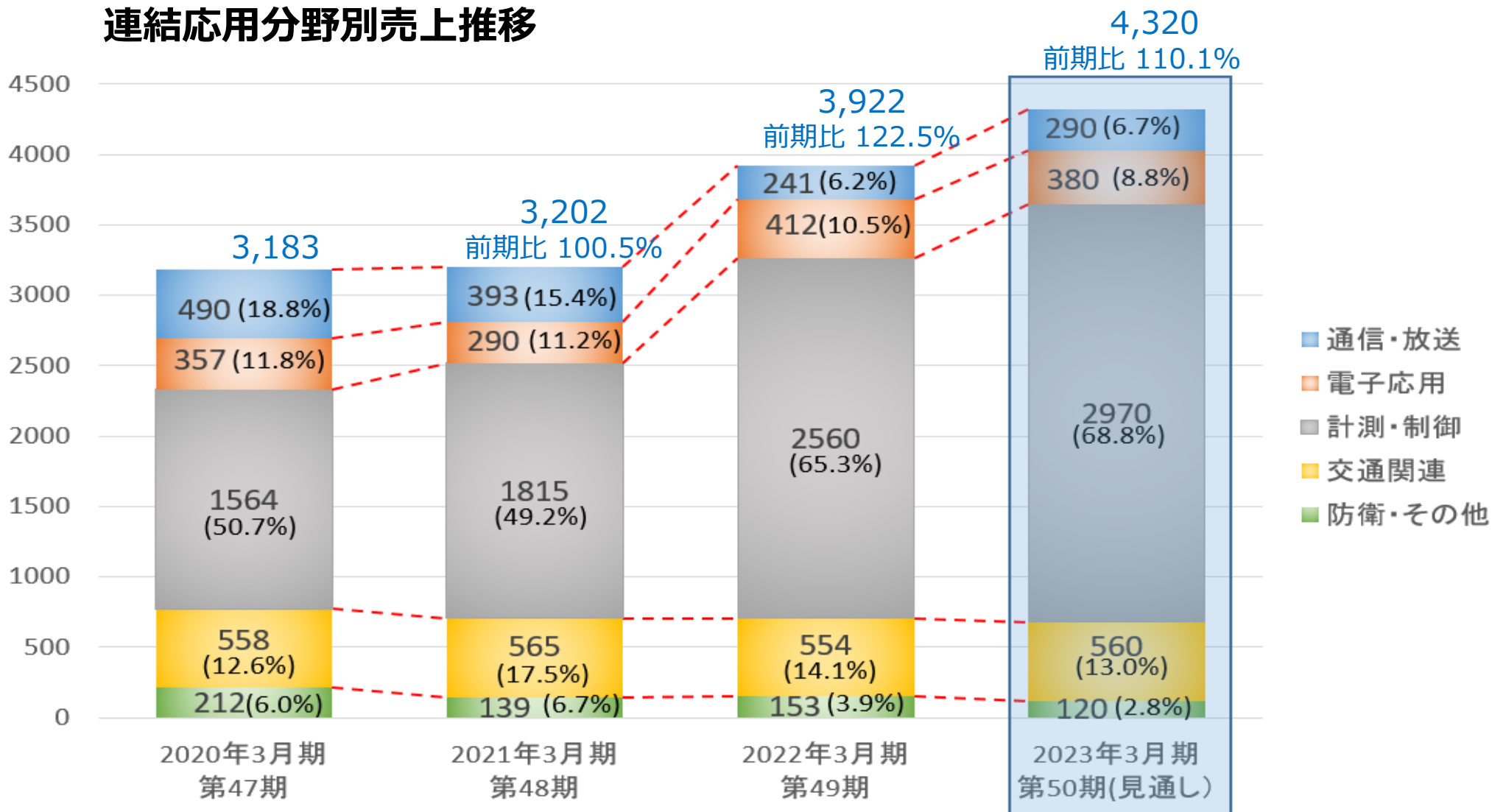


防衛・その他

- ✓ 例年並み～微減

単位：百万円

連結応用分野別売上推移

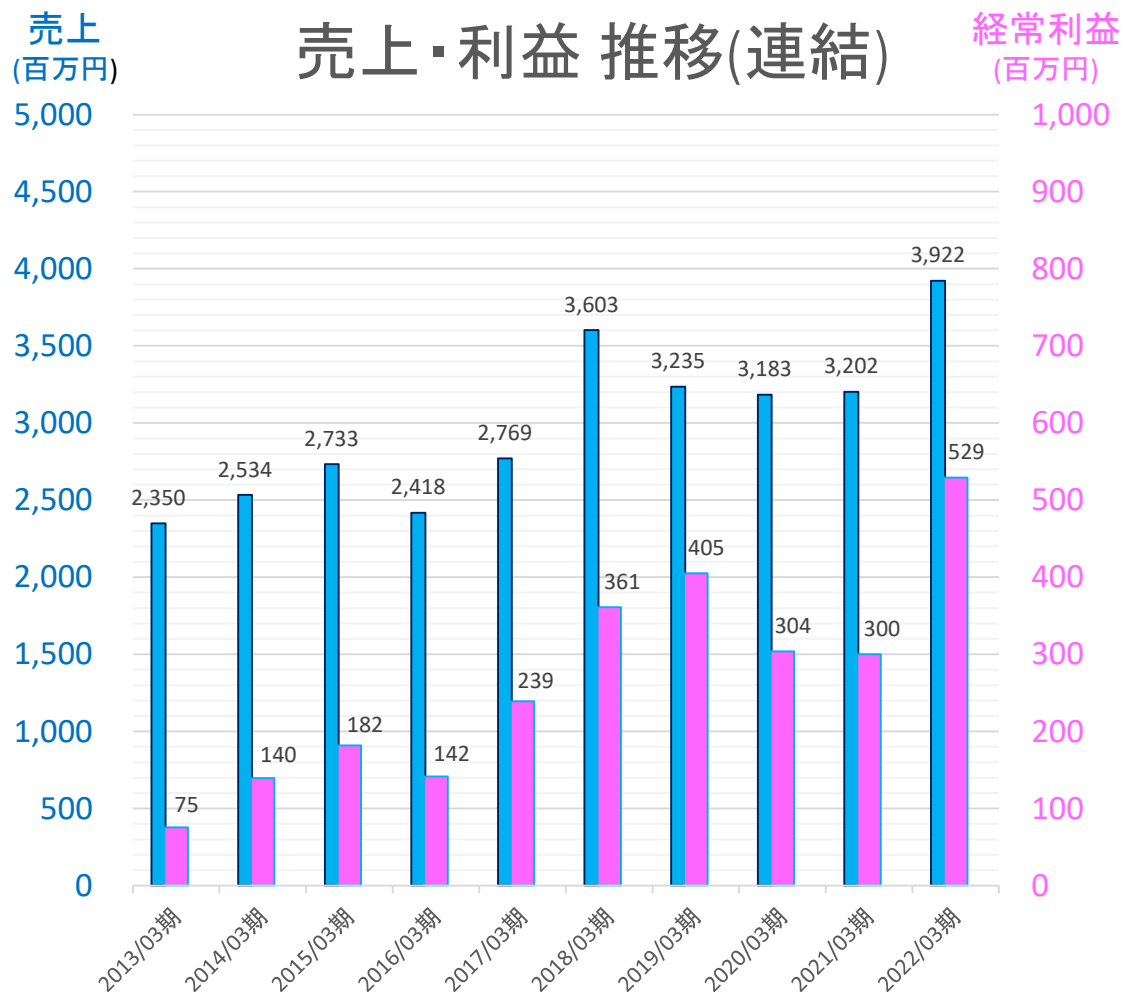




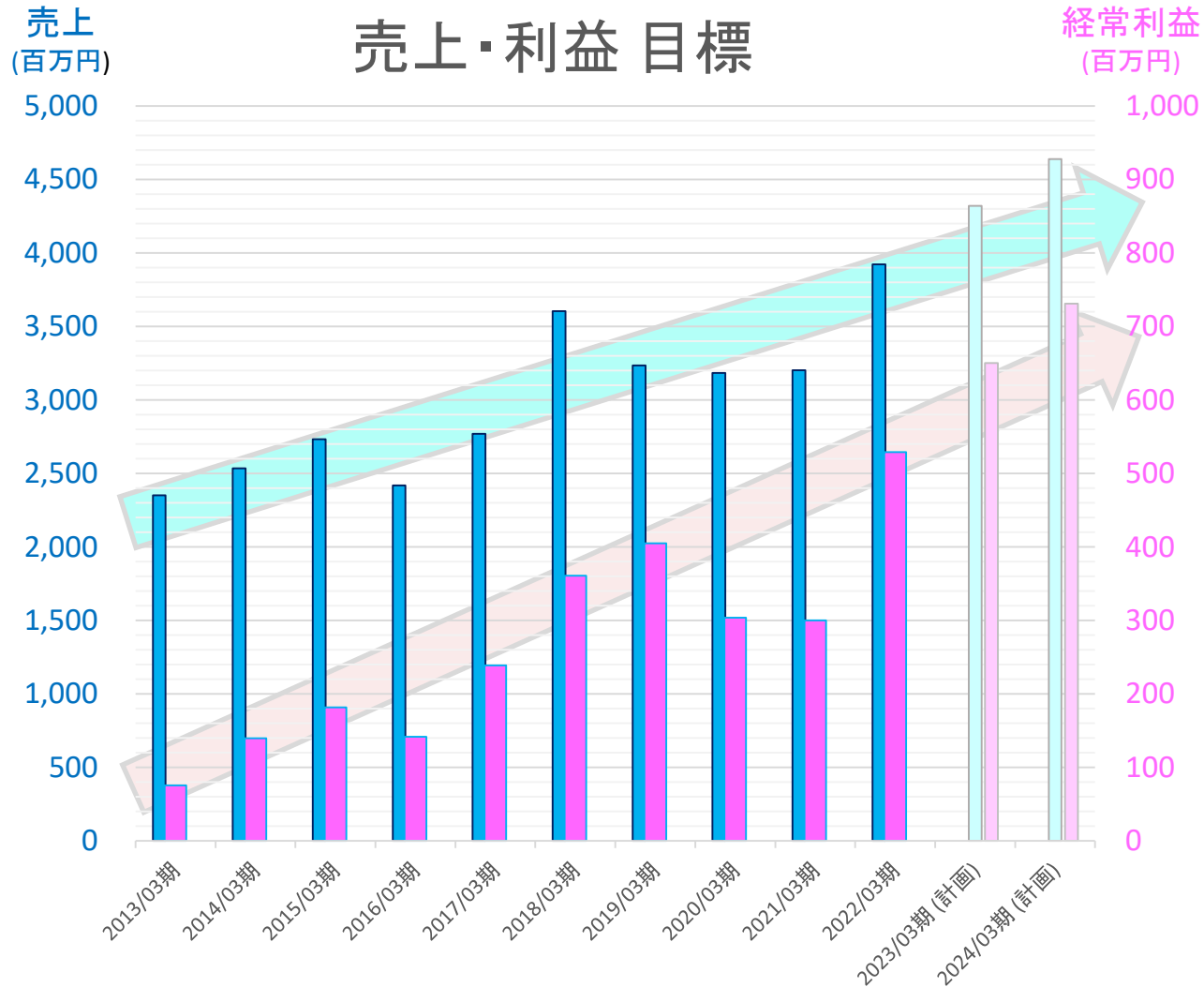
成長への取り組み

売上 : 23.5億円→39.2億円

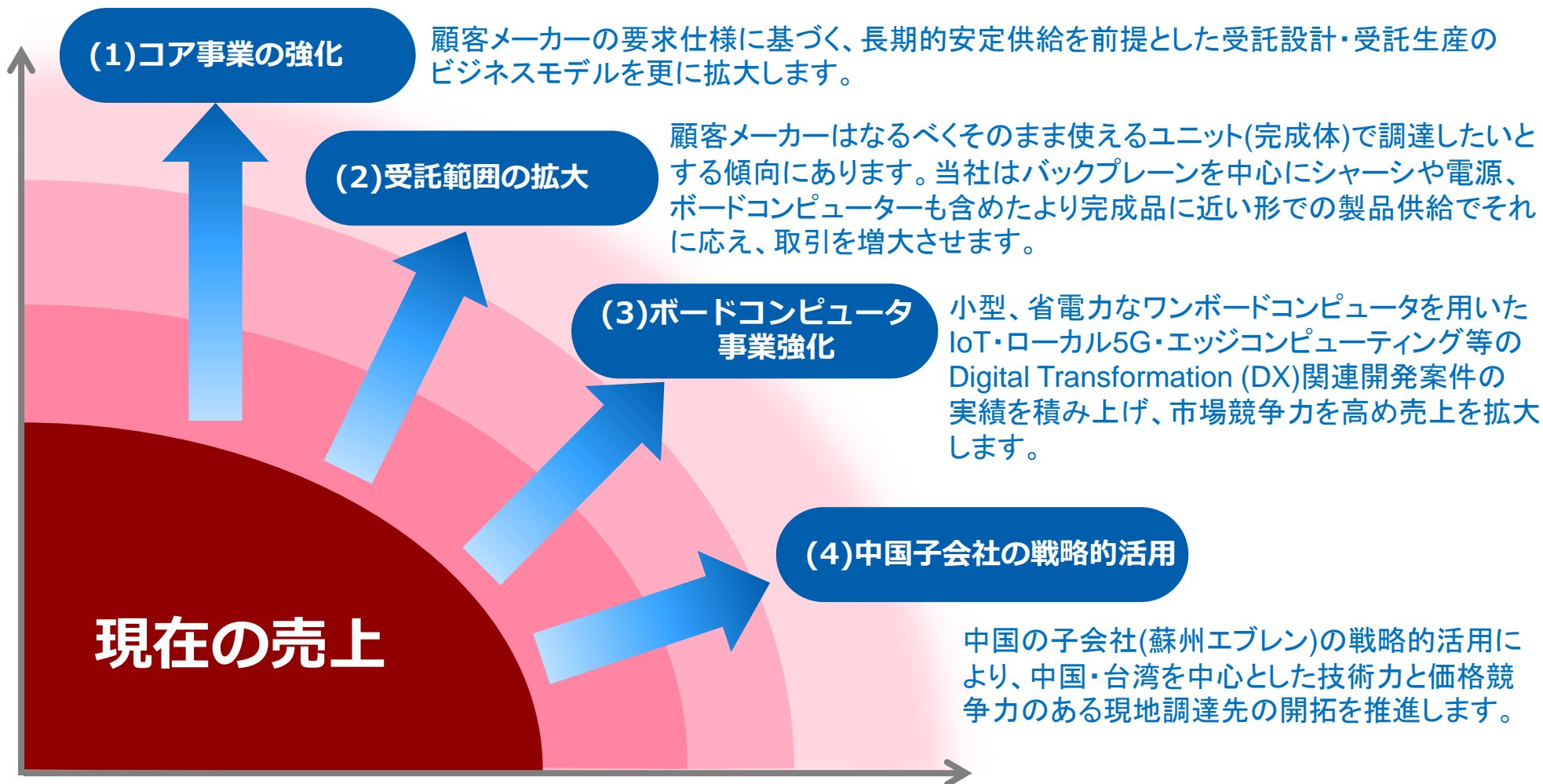
経常利益 : 75百万円→5億29百万円



年率10%~15%成長を目標として成長路線を堅持



より価値のあるソリューションの提供を通して企業価値の拡大を目指す



(1) コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく 受託設計・受託生産・長期的安定供給のビジネスモデルを更に拡大します。

大手システムメーカーの動向

過去

大手メーカーは設計・部材調達・生産など全てのプロセスを自社で完結していたが……

製品開発期間短縮の必要性の高まり

慢性的な技術リソース不足

技術の高度化・開発費の増大

今後

「選択と集中」が進み、ノウハウのある専門メーカーとの協業が拡大する

専門メーカーとしての優位性（**短納期・低コスト・高品質**）を生かし顧客メーカーとの協業を通じてノウハウや設計資産を蓄積

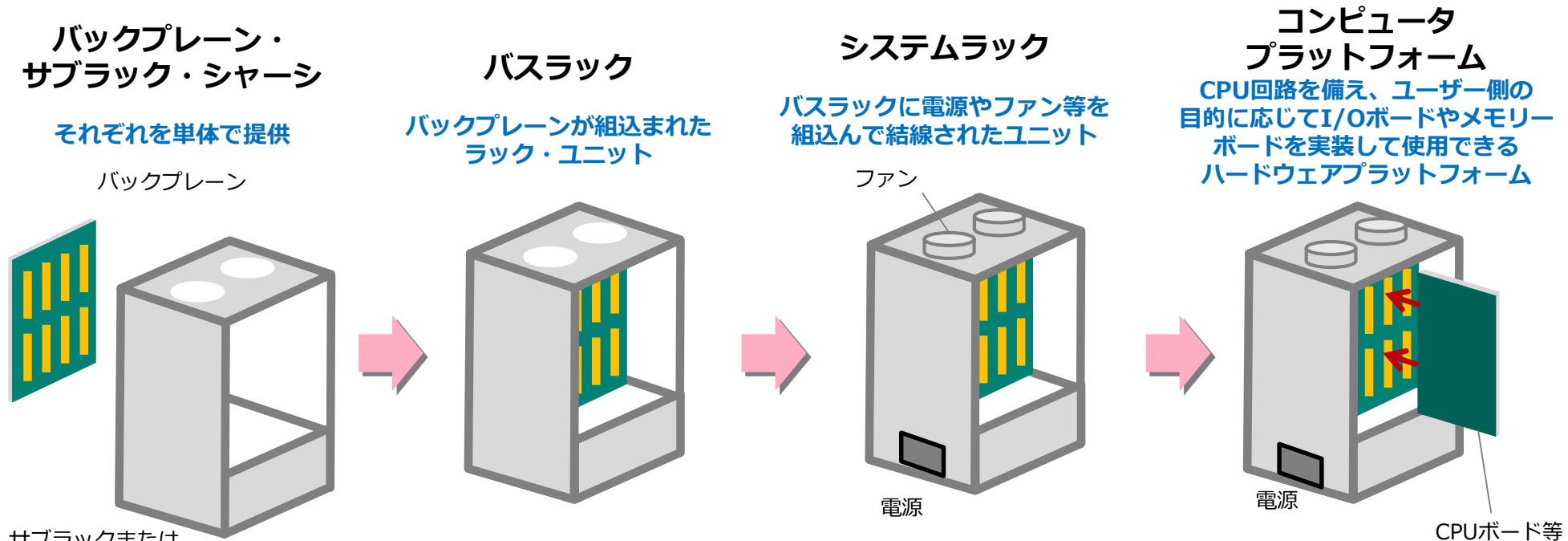
- ・類似案件の受注拡大
- ・事業領域の拡大
- ・要素技術の開発・拡充（**冷却構造、耐電磁波構造等**）
- ・部品共通化による調達力の強化
- ・標準製品、システムパーツの拡充（**FANアラームボード、標準部材等**）
- ・生産拡大に伴う生産設備増強

市場における優位性増大 = 事業拡大へ

(2) 受託範囲の拡大

当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。

お客様が本来の研究開発活動にリソースを集中していただけるよう、当社の受託範囲がより完成品に近い形となるよう供給体制を整備・拡充し、お客様の多様なニーズに応えます。



年々構成レベルの高い（完成品に近い）製品に対する需要が増加する傾向

受託範囲の拡大による業績拡大

(3) ボードコンピュータ事業強化

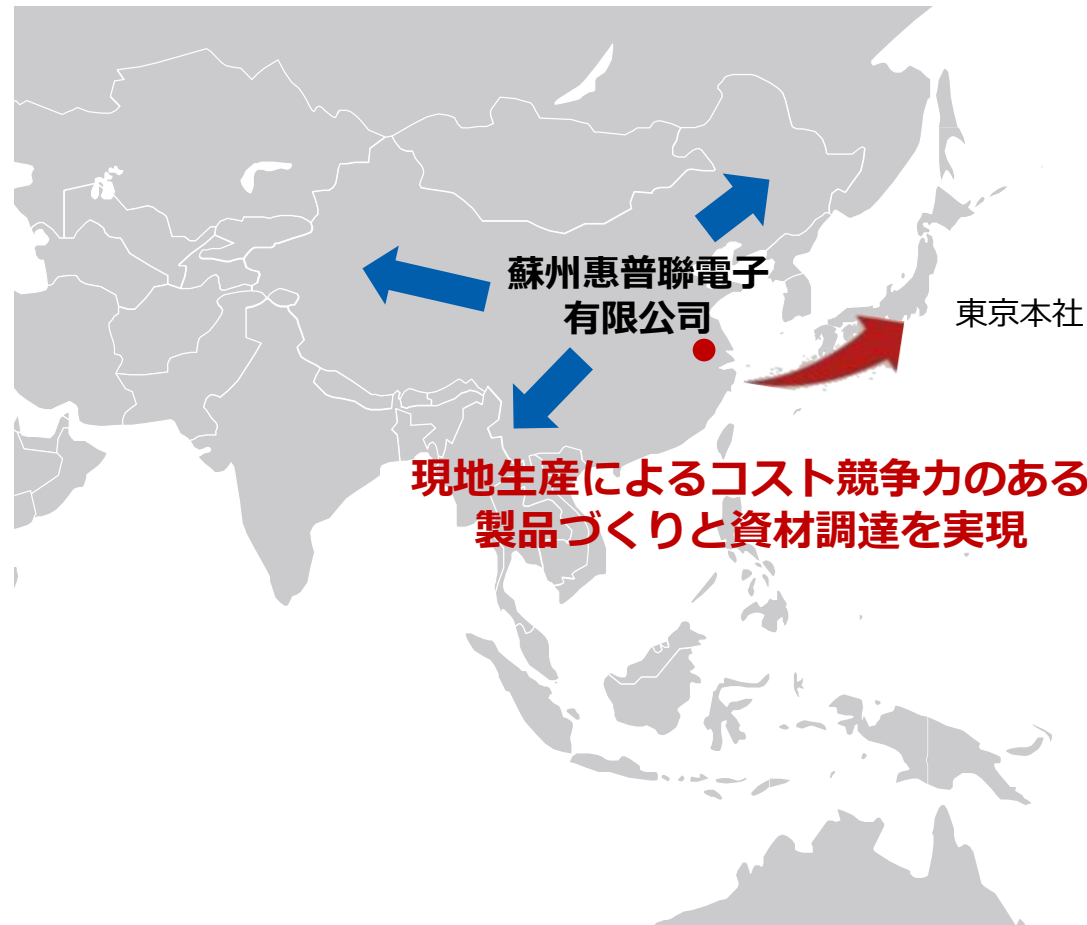
技術革新で小型化・低消費電力化が進み、IoT・ローカル5G・エッジコンピューティング等、小型ワンボードコンピュータを使用して実現するDigital Transformation (DX)関連の開発案件が増加している。

- ・ 極低遅延映像圧縮伝送システム（遠隔医療用途）
- ・ 高電圧・大容量直流遮断器（洋上風力発電向送電用途）
- ・ 低消費電力スーパーコンピュータ（AI用途）
- ・ 人検知システム（自走式産業車両安全管理用途）
- ・ プラント監視機器（アナログ計器監視機能）

※現在進行中の開発案件抜粋

(4) 中国子会社の活用強化

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地の部材調達先の開拓を推進します。現地企業および日系の進出企業へ現地生産によるコスト競争力のある製品を提供します。



蘇州惠普聯電子有限公司
概要

| | |
|-------|---|
| 会社名 | 蘇州惠普聯電子有限公司 |
| 本社所在地 | 中華人民共和国江蘇省蘇州市 |
| 創業開始 | 2002年9月 |
| 資本金 | 82百万円 |
| 株主構成 | 当社100% |
| 事業内容 | バックプレーン及びバスラック等の製造販売及び輸出入、部材の現地生産調達先の開拓 |

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかわる仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値とは異なる可能性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきますようお願い申し上げます。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

EBRAIN